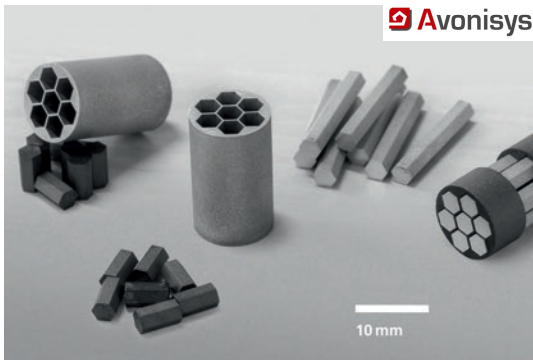


## clean CUTTING | SITEC



**Clean Cutting** Mit „Clean Cutting by SITEC“, dem wasserstrahlgeführten Laserschneiden werden gegenüber konventioneller Laserschneid- und Laserbohrtechnologie signifikante Vorteile erreicht. Die erzielbaren Ergebnisse sind mit denen von Erodierprozessen vergleichbar.

- Verfahrensvorteile**
- Qualitativ hervorragende Schneidkanten
  - Gratfreies Laserschneiden sehr dünner Bleche und Folien
  - Gratfreie, parallele Vereinzelung von Werkstücken bis zu 20mm dick, abhängig vom Material
  - Reduzierter Wärmeeintrag
  - Herstellung von Bohrungen mit sehr hohem Aspektverhältnis

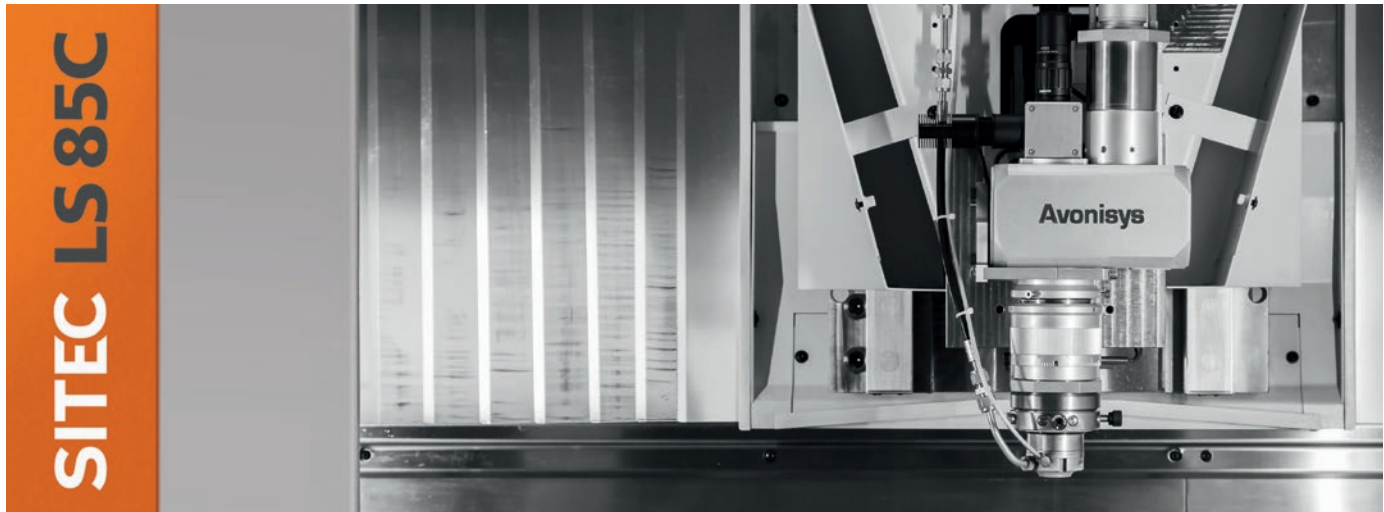
**Ihre SITEC-Lösung** Das Verfahren des wasserstrahlgeführten Laserschneidens wurde durch die Avonisy AG weiterentwickelt und ihr Leistungsspektrum optimiert. In Kooperation mit Avonisy bietet SITEC eine ganzheitliche Systemlösung aus Technologie und umfangreich automatisierbaren CNC-Bearbeitungsanlagen an.

Das modulare System der AVONISYS AG, bestehend aus Wasseraufbereitung, Strahlformung und Bearbeitungsoptik, wurde erfolgreich mit den etablierten Lasermaschinen der Baureihe LS vereint.

Die standardisierte und wartungsfreundliche Lösung lässt sich auch in automatisierte SITEC Lasersonderanlagen integrieren.

Für den Prozess lassen sich unterschiedliche Festkörperlaser integrieren. Aufgrund der Zuverlässigkeit und geringen Betriebskosten kommen vorzugsweise Faserlaser zum Einsatz.

**Serienfertigung** Alternativ bietet Ihnen SITEC eine Anlauf- oder Serienfertigung auf hauseigenen Anlagen in zertifizierter Qualität nach ISO9001 und IATF16949 an



### Produktionslösungen



#### Standardisierte Laseranlage

- Laserstandardanlage der Baureihe LS
- SIEMENS-Steuerung
- OEM Laserstrahlquelle
- Wasseraufbereitung
- Strahlformung und Bearbeitungsoptik
- Manuelle oder automatisierte Bestückung
- Spezifische Vorrichtungskonzepte
- Geringer Flächenbedarf
- Kurze Lieferzeiten

**So flexibel wie Sie!**



#### Vollautomatisierte Laseranlage

- Individuell automatisierte Laseranlage, auch als integrierte Lösung
- SIEMENS-Steuerung
- OEM Laserstrahlquelle
- Wasseraufbereitung
- Strahlformung und Bearbeitungsoptik
- Manuelle oder automatisierte Bestückung
- Spezifische Vorrichtungskonzepte
- VARIOVIEW® Traceability-System

**So fokussiert wie Sie!**